万联证券版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.张嘉仪.ybjieshou@eastm

万联证券 WANLIAN SECURITIES

村田官宣万亿日元扩产计划，台积电拟上调先进封装报价

——电子行业跟踪报告

强于大市（维持）

2026 年 11 月 02 日

行业核心观点：

上周申万电子指数下跌 13.82%，跑输沪深 300 指数和创业板指数。AI 算力需求催化下，村田官宣万亿日元 MLCC 扩产计划，台积电拟提高先进封装产品报价，印证算力基础设施建设仍处于高景气状态；三星及 SK 海力士预计存储供应短缺或仍将持续较长时间。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如 PCB、存储、MLCC 等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注 PCB、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

投资要点：

产业动态：（1）MLCC，全球 MLCC 龙头日本村田制作所近日官宣中长期扩产计划，2026 财年至 2030 财年的五年周期内，合计投入约 1 万亿日元（折合 422 亿人民币），主攻多层陶瓷电容器（MLCC）产能建设，以满足 AI 服务器、算力硬件对高端无源元器件的激增需求，目标到 2030 财年实现 MLCC 销售额较 2025 财年翻倍。**（2）先进封装，**据科创板日报，受 AI 需求爆发、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电计划上调先进芯片封装服务价格，最高涨幅可达 20%。**（3）存储，**三星在 Q3 财报电话会议上宣布，已与 10 家主要客户签署长期存储器供应协议（LTA），并正在与另外 10 家客户进行谈判。长期供应合同正在从超大规模数据中心扩展到服务器制造商、移动设备、汽车和网络设备等多个行业。SK 海力士已与包括全球大型云服务提供商在内的 14 家主要客户签署长期供应协议（LTA），锁定 2027-2028 年总产能的 50%以上，并计划在中长期内保持类似的比例锁定坚实的盈利基础。协议采用在商定价格范围内反映市场行情的机制，兼顾盈利稳定性与市场灵活性。SK 海力士在电话会议上表示，考虑到已签订的 LTA 和目前正在与客户洽谈的合同，未来三年（至 2029 年）的 DRAM 和 HBM 产能几乎全部售罄。

行业估值：从估值情况来看，截至 2026 年 11 月 1 日，SW 电子板块 PE(TTM)为 38.01 倍，2019 年至 2026 年 11 月 1 日 SW 电子板块 PE(TTM)均值为 56.85 倍，行业估值低于近年中枢水平。

风险因素：中美科技摩擦加剧；AI 应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

苹果发布首款折叠屏 iPhone Duo，三星 MLCC 交期涨到 52 周

提升产业链自主可控水平，全面实施“人工智能+”行动

村田计划扩建 MLCC 工厂，台积电扩产计划稳步推进

分析师： 夏清莹
执业证书编号：S0270520050001
电话：(0755) 8322 3620
邮箱：xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师： 陈达
执业证书编号：S0270524080001
电话：13122771895
邮箱：chenda@wlzq.com.cn

万联证券版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.张嘉仪.ybjieshou@eastm

正文目录

1 行业周观点.....3
2 市场行情回顾.....4
3 产业动态.....5
3.1 MLCC：村田官宣万亿日元扩产计划，高容 MLCC 缺口或延续.....5
3.2 先进封装：台积电拟将先进封装价格最高上调 20%.....5
3.3 存储：海外存储龙头厂商业绩表现较好，存储芯片供应仍较紧张.....6
4 风险提示.....6

图表 1： 申万一级周涨跌幅（%）.....4
图表 2： 申万一级年涨跌幅（%）.....4
图表 3： 申万电子板块估值情况（2019 年至今）.....5

万联证券版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.张嘉仪.ybjieshou@eastm

1 行业周观点

AI算力需求催化下，村田官宣万亿日元MLCC扩产计划，台积电拟提高先进封装产品报价，印证算力基础设施建设仍处于高景气状态；三星及SK海力士预计存储供应短缺或仍将持续较长时间。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB、MLCC等正处于景气扩张周期；此外，国产厂商先进技术创新突破，为AI芯片、先进封装优质厂商带来发展机遇，同时成熟领域产能扩充，有望提振上游半导体设备及材料等环节需求，带来投资机遇。

1）PCB，AI PCB行业受益于全球算力建设需求，高多层板及HDI市场需求增速相对较快，高端PCB扩产有望提振上游设备及材料需求，材料方面覆铜板供不应求推动产品涨价，设备方面曝光设备及钻孔设备等细分领域增速更高。建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，同时主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

2）存储，受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，我国存储龙头厂商积极把握行业发展机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商市场份额提升带来的投资机遇。

3）MLCC，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

4）先进封装，华为发布“韬定律”，通过逻辑折叠等技术创新推动芯片性能提升，先进封装是实践的重要技术环节之一，市场规模稳步增长。建议关注在先进封装各前沿技术领域前瞻布局的优质厂商，如在混合键合技术、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet技术等领域取得突破的龙头厂商。

5）AI芯片，国产AI芯片市场份额快速提升，由国产芯片、国产框架、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成。建议关注AI芯片领域技术创新突破并取得下游客户认可的国产优质厂商，在国产算力加速建设背景下产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

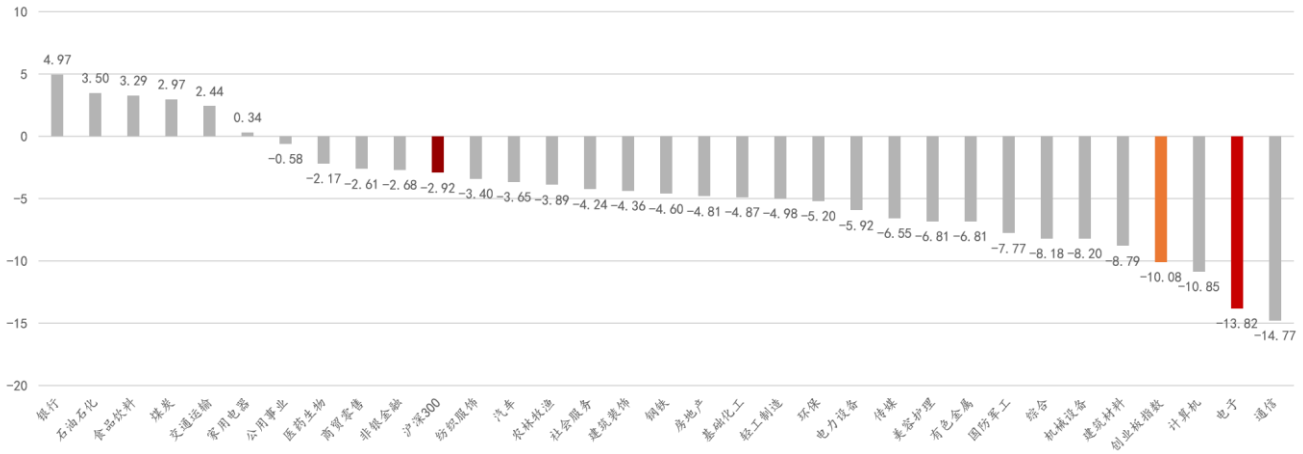
6）半导体设备及材料，国内晶圆厂加速推动产能扩充建设，有望提振上游半导体设备、零部件及材料需求，同时部分环节仍有较大国产替代空间。建议关注半导体设备、零部件及材料领域的优质龙头厂商，受益于下游扩产及国产替代双重增长动力，产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

万联证券版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.张嘉仪.ybjieshou@eastm

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑输沪深300指数和创业板指数。上周申万电子指数下跌13.82%，在31个申万一级行业中排第30，沪深300指数下跌2.92%，创业板指数下跌10.08%，申万电子跑输沪深300指数10.90个百分点，跑输创业板指数3.74个百分点。

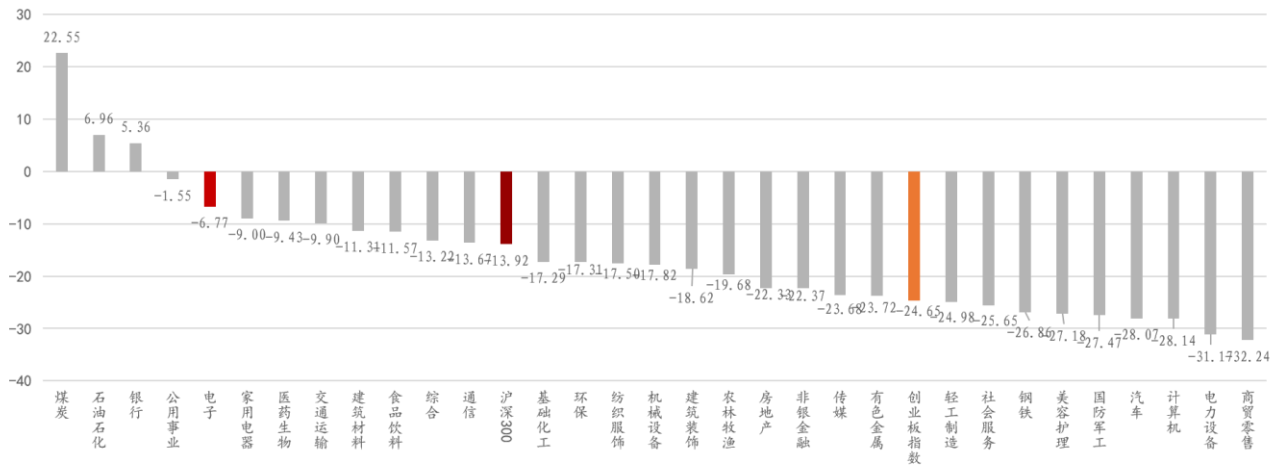
图表1：申万一级周涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年11月1日，沪深300指数下跌13.92%，创业板指数下跌24.65%，申万电子行业下跌6.77%，在31个申万一级行业中排名第5位，跑赢沪深300指数7.14个百分点，跑赢创业板指数17.87个百分点。

图表2：申万一级年涨跌幅（%）

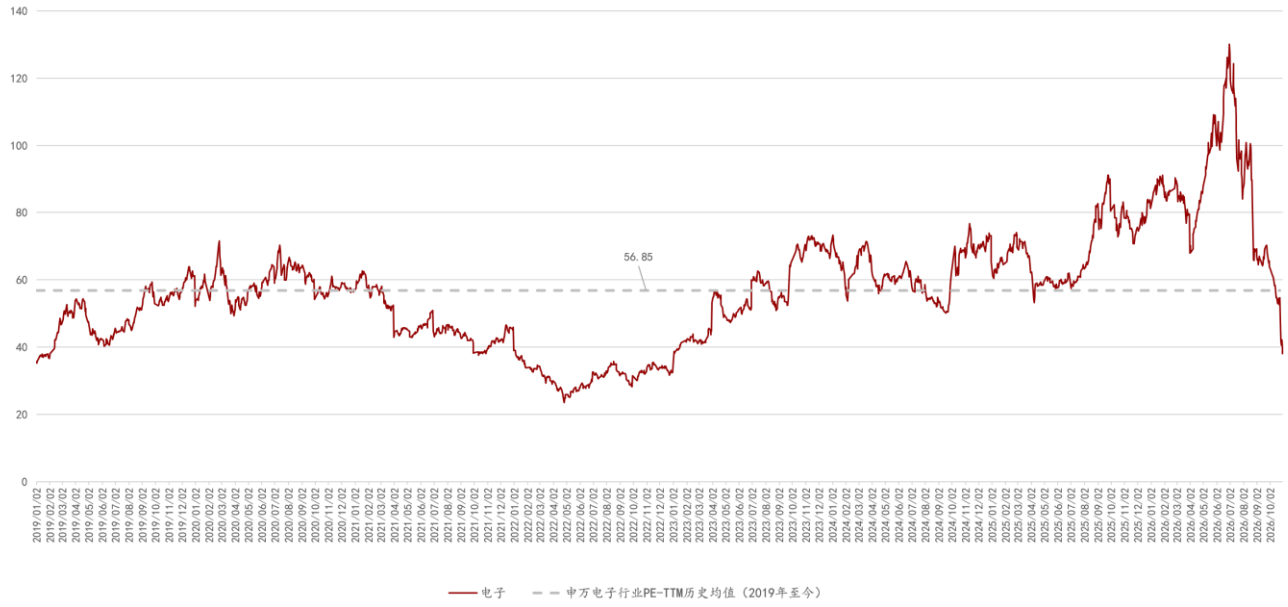


资料来源：iFinD，万联证券研究所

申万电子行业估值低于近年中枢。从估值情况来看，截至2026年11月1日，SW电子板块PE(TTM)为38.01倍，2019年至2026年11月1日SW电子板块PE(TTM)均值为56.85倍，行业估值低于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气上行等趋势利好，我们认为板块估值仍有上行空间。

万联证券版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.张嘉仪.ybjieshou@eastm

图表3：申万电子板块估值情况（2019年至今）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

3 产业动态

3.1 MLCC：村田官宣万亿日元扩产计划，高容MLCC缺口或延续

全球MLCC龙头日本村田制作所近日官宣中长期扩产计划，2026财年至2030财年的五年周期内，合计投入约1万亿日元（折合422亿人民币），主攻多层陶瓷电容器（MLCC）产能建设，以满足AI服务器、算力硬件对高端无源元器件的激增需求，目标到2030财年实现MLCC销售额较2025财年翻倍。本次万亿投资资金中，3500亿日元将投向厂房基建，剩余6500亿日元将用于采购产线设备、升级工艺，扩产布局覆盖日本本土、东南亚及中国原有基地。日本冈山基地是本轮重点，计划投入1500亿日元新建产线，新厂房预计2028年末逐步投产；泰国等海外工厂也将配套新增产线。AI服务器正在重塑MLCC的需求结构。不同于手机等消费电子对通用型电容的需求，AI算力主板、高速供电链路需要低等效串联电感、高稳定性的高端MLCC，单台AI服务器搭载的电容数量远高于传统服务器，且对耐压、温度稳定性提出严苛标准。村田社长中岛规巨在说明会上提到，数据中心、光通信基础设施已经进入持续扩容周期，需求上行节奏比此前预判更快，原有产能规划已经跟不上下游云厂商和芯片厂商的订单节奏。（来源：财联社）

根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，随着AI应用由模型训练走向推理与AI智能体，对CPU的需求量逐步提升。由于每颗CPU都需搭配电源模块与DDR5存储器，CPU主板与存储器模块周边的高容MLCC用量随之倍增，导致高容常规品供货尤为吃紧。在NVIDIA（英伟达）Vera Rubin 2026年第四季出货逐月放量，以及AMD（超威）MI450开始拉货高容特规品的情况下，ODM预期2027年第一、二季将是高端MLCC短缺较严重的时间点。TrendForce集邦咨询预估，高端MLCC缺口将延续至2027年上半年，定价主导权仍在卖方，即将于2026年11月启动的2027年第一季议价，日系厂商跟进SEMCO（三星电机）涨价的机率相对较大，其他厂商亦有望持续承接外溢的消费级订单。（来源：TrendForce集邦咨询）

3.2 先进封装：台积电拟将先进封装价格最高上调20%

据科创板日报，受AI需求爆发、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电计划上调先

进芯片封装服务价格，最高涨幅可达20%。报道称，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。当前，CoWoS的需求已经从图形处理器（GPU），延伸至服务器中央处理器（CPU）以及定制专用集成电路。与此同时，AI芯片测试周期更长，进一步加剧了封测产能的供给压力。芯片设备交期也随之拉长，从此前的3至6个月延长至6至8个月。一方面，芯片厂商争抢交付排期，另一方面，设备供应商难以快速扩产。台积电下游客户已无暇砍价，“只要能承诺交期便下单”。（来源：科创板日报）

3.3 存储：海外存储龙头厂商业绩表现较好，存储芯片供应仍较紧张

2026年第三季度（2026年7-9月），三星电子营收与营业利润继续刷新历史单季最高纪录，营业利润首次突破100万亿韩元，由此三星电子成为全球首家季度营业利润突破100万亿韩元的科技公司；但净利润低于市场预期，主要受财务费用上升拖累。三星在Q3财报电话会议上宣布，已与10家主要客户签署长期存储器供应协议（LTA），并正在与另外10家客户进行谈判。长期供应合同正在从超大规模数据中心扩展到服务器制造商、移动设备、汽车和网络设备等多个行业。合同采用滚动式运作模式，基本期限届满后可通过协商进行年度续约，部分客户的额外续约请求远超预期。三星预计，到2030年通过长期供应合同确保总产能60%至70%的可能性正在增加。三星电子在电话会上表示，已完成2027年HBM供应量的谈判，目标价格水平充分考虑了公司产品竞争力，目前已全部售罄，但仍有主要客户要求增加HBM供应。三星预测，即使2027年资本支出大幅增加，由于新建工厂成本上升和设备交付周期延长，2028年产量增长仍将受到限制。此外，HBM4E和下一代HBM5的芯片尺寸和工艺层数增加，导致每片晶圆产量下降，也是供应扩张的限制因素。三星预计存储芯片供应短缺将持续到2028年。

SK海力士发布截至2026年9月30日的2026财年第三季度财务报告：营业收入达104.62万亿韩元（约合733.8亿美元），历史上首次突破100万亿韩元大关，环比增长32%，同比增长328%；营业利润83.33万亿韩元（约合584.48亿美元），环比增长38%，同比增长632%，营业利润率高达80%，双双刷新季度历史纪录。SK海力士已与包括全球大型云服务提供商在内的14家主要客户签署长期供应协议（LTA），锁定2027-2028年总产能的50%以上，并计划在中长期内保持类似的比例锁定坚实的盈利基础。协议采用在商定价格范围内反映市场行情的机制，兼顾盈利稳定性与市场灵活性。SK海力士在电话会议上表示，考虑到已签订的LTA和目前正在与客户洽谈的合同，未来三年（至2029年）的DRAM和HBM产能几乎全部售罄。SK海力士评估认为，中长期销售前景已显著提升。SK海力士判断，AI应用普及带动基础设施投资扩张的良性循环已经确立，AI投资主体正从少数企业扩展至普通企业和国家层面，AI投资和需求强度将保持充分稳健。由于先进制程技术难度提升、新建生产设施耗时较长，供给端难以跟上市场增长速度，预计到2030年供不应求格局将持续。针对产能扩张可能导致供应过剩的问题等，SK海力士在电话会上表示，投资规模或新晶圆厂数量的增加并不一定会导致供应量成比例增加。当前的投资不仅是为了扩大产能，更旨在构建技术迭代和高附加值产品线扩张所需的生产基底。如果存储半导体需求下降幅度超出预期，将灵活调整设施投资和生产计划，分阶段推进执行。对于新建半导体工厂，将首先搭建厂房框架，然后分阶段开放洁净室，设备部署时间将根据客户需求而定。（来源：CFM闪存市场）

4 风险提示

中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10％以上；
同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10％至-10％之间；
弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10％以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15％以上；
增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5％至15％；
观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5％至5％；
卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5％以上。
基准指数 ： 沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责条款

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。
市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。
本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所
上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦
北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心
深圳福田区深南大道 2007 号金地中心
广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场